台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 109. 10. 22 文
檔號: 109721
109002041023

財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：林秀姿
電話：03-5916636
傳真：03-5820466
E-mail：iris.lin@itri.org.tw

241403 三重區重新路五段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 109 年 10 月 21 日
發文字號：工研轉字第 1090020410 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：本院擬舉辦「雷射與積層製造技術相關專利非專屬授權案」之公開說明會，敬請轉知貴會會員把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權能量，本院將舉辦「雷射與積層製造技術相關專利非專屬授權案」之公開說明會，可授權標的包括專利 36 案 71 件(詳如附件)，歡迎貴會會員踴躍參與。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：
工研院研發成果公告網站
(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1073226421136552352)

三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：分兩地舉行，舉辦時間相同，分述如下
（一）北部場：民國 109 年 11 月 11 日(星期三)下午 3 時

至 4 時，地點為新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 2A 室。

（二）南部場：民國 109 年 11 月 11 日(星期三)下午 3 時至 4 時，地點為台南市六甲區工研路 8 號北研館 415 室。

五、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 11 月 9 日中午 12 時整（含）前，以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「109 年度工研院雷射與積層製造技術等相關專利非專屬授權案：公開說明會報名(請標示北部場或南部場)」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱、參與人手機號碼）。本案聯絡人將於 109 年 11 月 10 日下午 5 時整（含）前，發送電子郵件回覆，並告知公開說明會會議資訊。

六、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

109 年度工研院

雷射與積層製造技術等相關專利非專屬授權案

一、**主辦單位：**財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。

二、**非專屬授權標的：**雷射、積層製造及顯示相關專利（36 案 71 件），詳如附件。

三、**非專屬授權廠商資格：**國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：

（一）舉辦地點：

（1）北部場：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 2A 室。

（2）南部場：台南市六甲區工研路 8 號北研館 415 室。

（二）舉辦時間：

皆於民國（下同）109 年 11 月 11 日下午 3 時至 4 時。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名此場者，請於 109 年 11 月 9 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「**109 年度工研院雷射與積層製造技術等相關專利非專屬授權案：公開說明會報名**(請標示**北部場**或**南部場**)」，並於內文中陳明：**公司名稱**、**公司電話**、**參與人數**、**姓名**、**職稱**、**參與人手機號碼**）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 11 月 10 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心　林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：專利授權標的 (36 案 71 件)

一、 雷射技術 (23 案 43 件)

子分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	種類	申請號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
光學系統	1	1	P70080004TW	雷射加工系統與折疊式鏡組保護裝置	審查中	台灣	發明	108142688				經濟部技術處
	1	2	P70080004CN	激光加工系統與折疊式鏡組保護裝置	審查中	中國	發明	201911279656.0				經濟部技術處
	2	3	P70080011TW	掃描式光源模組	審查中	台灣	發明	109104360				經濟部技術處
	2	4	P70080011CN	掃描式光源模塊	審查中	中國	發明	202010207883.9				經濟部技術處
	2	5	P70080011US	掃描式光源模組	審查中	美國	發明	16/881,010				經濟部技術處
	3	6	P70080009TW	貝索光束均質模組	審查中	台灣	發明	108144697				經濟部技術處
表面處理	4	7	P27040014TW	骨骼植入物及其製造方法	獲證	台灣	發明	104140192	I548391	20160911	20351130	經濟部技術處
	4	8	P27040014US	骨骼植入物及其製造方法	獲證	美國	發明	14/985,381	10,603,093	20200331	20361211	經濟部技術處
	4	9	P27040014USD1	骨骼植入物及其製造方法	審查中	美國	發明	16/807,557				經濟部技術處
雷射切割	5	10	P70070009TW	形成導角的切割方法	獲證	台灣	發明	107139884	I678342	20191201	20381108	經濟部技術處
	5	11	P70070009CN	形成導角的切割方法	審查中	中國	發明	201811473108.7				經濟部技術處
	5	12	P70070009US	形成導角的切割方法	審查中	美國	發明	16/279,186				經濟部技術處
	6	13	P70080001TW	雷射半切加工方法及其裝置	審查中	台灣	發明	108135159				經濟部技術處
	7	14	P70070001TW	晶圓切割方法	審查中	台灣	發明	107111598				經濟部技術處
	8	15	P70070002TW	硬脆材料切割方法及其裝置	獲證	台灣	發明	107111518	I677395	20191121	20380330	經濟部技術處
	8	16	P70070002CN	硬脆材料切割方法及其裝置	審查中	中國	發明	201810325016.8				經濟部技術處
	9	17	P70070007TW	加工裝置	獲證	台灣	發明	107141660	I699251	20200721	20381121	經濟部技術處

子分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	種類	申請號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
雷射掃描/校正	10	18	P27030015TW	三維雷射加工裝置及定位誤差校正方法	獲證	台灣	發明	103140242	I577484	20170411	20341119	經濟部技術處
	10	19	P27030015CN	三維激光加工裝置及定位誤差校正方法	獲證	中國	發明	201510021836.4	ZL201510021836.4	20171205	20350115	經濟部技術處
	10	20	P27030015DE	三維雷射加工裝置及定位誤差校正方法	獲證	德國	發明	EP15193797.6	EP3045256	20190417	20351109	經濟部技術處
雷射清潔	11	21	P70060004TW	雷射清潔裝置及方法	獲證	台灣	發明	106119768	I651136	20190221	20370613	工研院
	11	22	P70060004CN	激光清潔裝置及方法	審查中	中國	發明	201710669824.1				工研院
	12	23	P70060019TW	雷射清潔裝置及方法	獲證	台灣	發明	107112771	I686256	20200301	20380412	工研院
	12	24	P70060019CN	激光清潔裝置及方法	審查中	中國	發明	201810447134.6				工研院
	12	25	P70060019US	雷射清潔裝置及方法	審查中	美國	發明	16/133,199				工研院
雷射銲接	13	26	P70080012TW	銲接品質檢測系統與方法	審查中	台灣	發明	108141851				經濟部技術處
	13	27	P70080012US	銲接品質檢測系統與方法	審查中	美國	發明	16/724,551				經濟部技術處
雷射轉印	14	28	P70070006TW	雷射刻印製程	審查中	台灣	發明	107144645				經濟部技術處
複材接合技術	15	29	P70080002TW	料帶貼合設備	獲證	台灣	發明	108128969	I678329	20191201	20390813	經濟部技術處
	15	30	P70080002US	料帶貼合設備	審查中	美國	發明	16/660,694				經濟部技術處
	16	31	P70090004TW	料帶貼合設備	審查中	台灣	發明	109130322				經濟部技術處
監測與控制	17	32	P70060012TW	雷射驅動器及其雷射光源驅動方法	獲證	台灣	發明	107100387	I659583	20190511	20380103	經濟部技術處
	17	33	P70060012US	雷射驅動器及其雷射光源驅動方法	獲證	美國	發明	16/156,147	10,447,008	20191015	20381009	經濟部技術處
	18	34	P70070008TW	雷射裝置	獲證	台灣	發明	107145379	I699937	20200721	20381216	經濟部技術處
	19	35	P70070010TW	脈衝延遲可調光纖雷射系統	獲證	台灣	發明	107145147	I678038	20191121	20381213	經濟部技術處
	19	36	P70070010CN	脈衝延遲可調光纖激光系統	審查中	中國	發明	201811580595.7				經濟部技術處
	20	37	P70080008TW	具有雷射動態補償功能的掃描式雷射系統及掃描式雷射動態補償方法	審查中	台灣	發明	108142142				經濟部技術處

子分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	種類	申請號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
監測與控制	20	38	P70080008CN	可激光動態補償的掃描式激光系統及其激光動態補償方法	審查中	中國	發明	201911292290.0				經濟部技術處
	21	39	P70080010TW	功率量測保護方法與雷射保護系統	審查中	台灣	發明	108143406				經濟部技術處
	21	40	P70080010US	功率量測保護方法與雷射保護系統	審查中	美國	發明	16/727,202				經濟部技術處
	22	41	P70080014TW	反射光偵測模組	審查中	台灣	發明	108147102				經濟部技術處
	22	42	P70080014CN	反射光檢測模塊	審查中	中國	發明	201911391434.8				經濟部技術處
	23	43	P70090002TW	同步光電驅動控制系統及方法	審查中	台灣	發明	109128954				經濟部技術處

二、積層製造技術 (12 案 26 件)

子分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	種類	申請號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
製程與控制	1	1	P70080007TW	環控粉末處理系統及其方法	審查中	台灣	發明	108141081				經濟部技術處
	2	2	P70080003TW	製程參數鑑別方法、系統以及非暫時性電腦可讀儲存媒體	審查中	台灣	發明	108147356				經濟部技術處
	3	3	P70080013TW	參數分析方法、電子裝置以及非暫時性電腦可讀儲存媒體	審查中	台灣	發明	108136199				工研院
	4	4	P70070012TW	金屬工件成型方法及金屬工件成型裝置	審查中	台灣	發明	108111801				經濟部技術處
	5	5	P27020045TW	調控積層製造之裝置及其方法	獲證	台灣	發明	102147539	I511823	2015 1211	2033 1219	經濟部技術處
	5	6	P27020045US	調控積層製造之裝置及其方法	獲證	美國	發明	14/477,249	9,884,455	2018 0206	2035 1224	經濟部技術處
	5	7	P27020045USD1	調控積層製造之裝置及其方法	獲證	美國	發明	15/850,096	10,695,977	2020 0630	2035 0720	經濟部技術處
	5	8	P27020045DE	調控積層製造之裝置及其方法	獲證	德國	發明	EP14187224.2	EP2891533	2019 1211	2034 0930	經濟部技術處
	5	9	P27020045GB	調控積層製造之裝置及其方法	獲證	英國	發明	EP14187224.2	EP2891533	2019 1211	2034 0930	經濟部技術處

子分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	種類	申請號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
	5	10	P27020045FR	調控積層製造之裝置及其方法	獲證	法國	發明	EP14187224.2	EP2891533	2019 1211	2034 0930	經濟部技術處
醫材應用	6	11	P70070003TW	生物材料列印設備	獲證	台灣	發明	107131662	I674201	2019 1011	2038 0909	經濟部技術處
	6	12	P70070003US	生物材料列印設備	審查中	美國	發明	16/262,346				經濟部技術處
	7	13	P70060014TW	義肢	獲證	台灣	發明	106143102	I643606	2018 1211	2037 1207	經濟部技術處
	7	14	P70060014CN	假肢	審查中	中國	發明	201811129956.6				經濟部技術處
	7	15	P70060014US	義肢	獲證	美國	發明	15/844,648	10,433,985	2019 1008	2038 0503	經濟部技術處
	8	16	P70070004TW	踝足矯型器	獲證	台灣	發明	107145914	I699197	2020 0721	2038 1218	經濟部技術處
	8	17	P70070004CN	踝足矯型器	審查中	中國	發明	201910489876.X				經濟部技術處
	8	18	P70070004US	踝足矯型器	審查中	美國	發明	16/232,623				經濟部技術處
	9	19	P70070005TW	可調整式支架	獲證	台灣	發明	107145879	I688378	2020 0321	2038 1218	經濟部技術處
	9	20	P70070005CN	可調整式支架	審查中	中國	發明	201910489859.6				經濟部技術處
	9	21	P70070005US	可調整式支架	審查中	美國	發明	16/229,845				經濟部技術處
	10	22	P70070011TW	可擴張之韌帶固定裝置	獲證	台灣	發明	107144099	I689296	2020 0401	2038 1206	經濟部技術處
	11	23	P70080005TW	口顎重建彌補物	暫准	台灣	發明	108138259				經濟部技術處
	11	24	P70080005US	口顎重建彌補物	審查中	美國	發明	16/725,502				經濟部技術處
	12	25	P70080006TW	口顎重建彌補物	審查中	台灣	發明	108137696				經濟部技術處
	12	26	P70080006US	口顎重建彌補物	審查中	美國	發明	16/725,641				經濟部技術處

三、顯示技術 (1 案 2 件)

子分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	種類	申請號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
電致變色	1	1	P70080015TW	電致變色元件製造方法	獲證	台灣	發明	100143098	I430005	20140311	20311123	經濟部技術處
	1	2	P70080015US	電致變色元件製造方法	獲證	美國	發明	13/649,408	8,992,719	20150331	20331016	經濟部技術處

【備註】: 本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。